



【茨城】半導体製造装置（ウェーハ面取り関連）のアプリケーションエンジニア

東京証券取引所プライム市場に上場・半導体製造装置と精密計測機器の製造販売

Job Information

Recruiter

[GLOBAL RESEARCH INC.](#)

Hiring Company

東京証券取引所プライム市場に上場・半導体製造装置と精密計測機器の製造販売

Job ID

1572973

Industry

Machinery

Company Type

Large Company (more than 300 employees)

Job Type

Permanent Full-time

Location

Ibaraki Prefecture, Tsuchiura-shi

Salary

6.5 million yen ~ 8 million yen

Holidays

完全週休2日制（土・日）、祝、年間休日128日

Refreshed

January 20th, 2026 11:13

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 3 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation (Amount Used: English usage about 10%)

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【概要】

ウェーハ面取り機を使用した加工技術開発業務

具体的には、

- ・ウェーハ研削面取り機を使用し新しい加工プロセスの研削評価
- ・ウェーハ研削面取り装置を使用し加工提案・企画・加工プロセスの開発
- ・ウェーハ研削面取り装置を使用しお客様から依頼の面取り研削加工

【年俸】
645万円～795万円

【勤務地】
茨城県土浦市

Required Skills

【必要職務経験】

- ・Office系ソフト等のPC使用が行える方、かつ装置と加工工具を使用し加工評価の経験のある方

【歓迎職務経験】

- ・工学系（機械工学）出身の方
- ・研削装置を使用し研削評価の経験のある方
- ・英語での会話経験がある方

Company Description